

2014-2018年中国铜箔市场 监测及投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2014-2018年中国铜箔市场监测及投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/jinshu1312/D571988RS2.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2013-12-11

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2014-2018年中国铜箔市场监测及投资前景研究报告》共十章。首先介绍了世界铜箔产业运行态势、中国铜箔市场运行环境等，接着分析了中国铜箔市场发展的现状，然后介绍了中国铜箔市场竞争格局。随后，报告对中国铜箔行业做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国铜箔市场发展前景与投资预测。您若想对铜箔产业有个系统的了解或者想投资铜箔行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

铜箔是现代电子行业不可替代的基础材料。工业用铜箔可常见分为压延铜箔（RA铜箔）与电解铜箔（ED铜箔）两大类，其中压延铜箔具有较好的延展性等特性，是早期软板制程所用的铜箔，而电解铜箔则是具有制造成本较压延铜箔低的优势。由于压延铜箔是软板的重要原材料，所以压延铜箔的特性改良和价格变化对软板产业有一定的影响。

由于压延铜箔的生产厂商较少，且技术上也掌握在部份厂商手中，因此客户对价格和供应量的掌握度较低，故在不影响产品表现的前提下，用电解铜箔替代压延铜箔是可行的解决方式。但若未来数年因为铜箔本身结构的物理特性将影响蚀刻的因素，在细线化或薄型化的产品中，另外高频产品因电讯考量，压延铜箔的重要性将再次提升。

铜箔是现代电子行业不可替代的基础材料，按制造工艺的不同分为压延铜箔和电解铜箔两类。根据应用领域及功率规格不同，电解铜箔可分为锂电铜箔（7 - 20微米）、标准铜箔（12 - 70微米）、超厚铜箔（105 - 420微米），其中：锂电铜箔主要应用于锂离子电池领域；标准铜箔、超厚铜箔根据其自身厚度和技术应用于不同功率的印制电路板（PCB）。在印制电路板上，电解铜箔用来充当电子元器件之间互连的导线。

对于国（境）外投资控股的企业，其生产规模都相对较大，所用技术均是国（境）外成熟的技术，使用进口生产设备，投资成本较高，但产品毛利率稳定，以规模优势参与市场竞争。但大部分上述企业生产的铜箔绝大部分自用生产下游产品，减弱了行业竞争压力。

对于国内技术自建的企业，多为原国有企业，其使用的是国内自主研发的生箔（即：将原材料经过溶铜这一工序后形成的铜箔）技术。随着产品性能的更新换代，加之管理体制和经营机制的问题，在新产品研发方面的投入（人力、财力）严重不足，致使部分企业被迫停产，还有一些企业处于重组进程之中。

对于结合国（境）外技术与自行研发技术建立的内资企业，这类企业在采用国（境）外成熟的生箔技术的基础上，还自行研发技术，在技术方面具有较强的竞争力，但规模有限。在这类企业中，中科英华连体机技术是目前我国铜箔行业中具有领先水平的独有技术，该技术改进了铜箔加工过程中影响铜箔质量的一系列因素，并提高了生箔的生产效率。但随着其他

企业的生产技术的改进和扩产完成，可能加剧行业竞争。

第一章 2013年世界铜箔产业运行态势分析

第一节 2013年世界铜箔产业运行环境综述

第二节 2013年世界铜箔业运行概况

一、世界电解铜箔业发展与演进

二、世界铜箔生产工艺研究

三、国外PCB用铜箔技术新发展

四、全球压延铜箔市场动态分析

第三节 2013年世界主要铜箔生产国家运行分析

一、美国

二、日本

三、韩国

第四节 2014-2019年世界铜箔市场发展趋势分析

第二章 2013年世界压延铜箔重点企业运行浅析

第一节 Nippon Mining（日本）

第二节 福田金属Fukuda、Olin brass（美国）

第三节 Hitachi Cable（日本）

第四节 Microhard（日本）

第三章 2013年中国铜箔市场运行环境解析

第一节 国内宏观经济环境分析

一、GDP历史变动轨迹分析

二、固定资产投资历史变动轨迹分析

三、2014年中国宏观经济发展预测分析

第二节 2013年中国铜箔市场政策环境分析

一、锂离子用铜箔技术标准

二、中国铜箔基础板出口退税政策调整

第三节 2013年中国铜箔市场社会环境分析

第四章 2013年中国铜箔市场发展现状综述

第一节 2013年中国铜箔业发展动态

一、铜箔行业发展规模分析

二、铜箔产业发展机遇分析

三、铜箔产品价格走势分析

第二节 2013年中国铜箔技术水平分析

一、新CO₂雷射直接铜箔加工技术

二、中国攻克18微米铜箔技术

三、铜箔分离技术

第三节 2013年中国铜箔业发展中存在的问题

第五章 2013年中国铜箔市场运营情况分析

第一节 2013年中国铜箔业市场运行分析

一、中国铜箔市场供给情况分析

二、中国铜箔市场消费情况分析

三、国内铜箔需求形势分析

第二节 中国铜箔市场运营动态分析

一、中科英华万吨电解铜箔项目力争年内投产

二、梅雁铜箔被列为国家重点新产品

三、松下电工开发出传输低损耗的LCP柔性覆铜箔板

第六章 2011-2013年中国铜箔制造行业数据监测分析

第一节 2011-2013年中国铜箔制造行业总体数据分析

一、2011年中国铜箔制造行业全部企业数据分析

二、2012年中国铜箔制造行业全部企业数据分析

三、2013年中国铜箔制造行业全部企业数据分析

第二节 2011-2013年中国铜箔制造行业不同规模企业数据分析

一、2011年中国铜箔制造行业不同规模企业数据分析

二、2012年中国铜箔制造行业不同规模企业数据分析

三、2013年中国铜箔制造行业不同规模企业数据分析

第三节 2011-2013年中国铜箔制造行业不同所有制企业数据分析

一、2011年中国铜箔制造行业不同所有制企业数据分析

二、2012年中国铜箔制造行业不同所有制企业数据分析

三、2013年中国铜箔制造行业不同所有制企业数据分析

第七章 2013年中国铜箔市场竞争格局透析

第一节 2013年中国铜箔市场竞争现状分析

- 一、铜箔市场技术竞争
- 二、铜箔市场综合竞争力分析
- 三、铜箔成本竞争分析

第二节 2013年中国铜箔行业集中度分析

- 一、铜箔市场集中度
- 二、铜箔行业区域集中度

第三节 2014-2019年中国铜箔业竞争策略分析

第八章 2013年中国铜箔行业内优势企业竞争力及关键性数据分析

第一节 中科英华 (600110)

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第二节 海亮股份 (002203)

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第三节 鑫科材料 (600255)

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第四节 广东超华科技股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第五节 山东金宝电子股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第六节 惠州合正电子科技有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第七节 松下电工电子材料(广州)有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第八节 四会市达博文实业有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第九节 梅州市威华铜箔制造有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第十节 广东梅县梅雁电解铜箔有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第九章 2013年中国PCB行业发展状况分析

第一节 2013年中国印刷电路板行业的总体概况

一、中国印刷电路板行业增长速度远高于行业平均速度

二、我国将成为世界最大产业基地

三、台湾柔性PCB公司在华东形成产业集群

四、低端PCB（4层以下）竞争比较充分，集中度较低

五、高端PCB（HDI等）处于供不应求的状态

第二节 2013年我国印刷电路板市场发展现状分析

一、印刷电路板市场生产结构分析

二、印刷电路板市场需求特点分析

三、印刷电路板市场技术发展分析

第三节 2013年我国印刷电路板行业发展存在的主要问题分析

一、产品集中于中低端成本转嫁能力弱

二、应对专利和新环保政策

三、内地本土所贡献的产出值比例很小

第四节 2013年中国印刷电路行业发展对策分析

第十章 2014-2019年中国铜箔市场发展趋势与前景展望分析

第一节 2014-2019年中国铜箔市场发展前景展望

一、电子级铜箔尤其是高性能箔市场看好

二、铜箔产品前景光明

三、中国电解铜箔市场前景趋好

第二节 2014-2019年中国铜箔产业发展趋势前瞻

一、电解铜箔业的发展趋势

二、铜箔业技术发展趋势

第三节 2014-2019年中国铜箔市场走势预测

一、铜箔供需预测分析

二、铜箔价格走势预测

三、铜箔进出口贸易预测分析

第四节 2014-2019年中国铜箔业市场盈利能力预测分析

第十一章 2014-2019年中国铜箔市场投资战略研究

第一节 2014-2019年中国铜箔投资环境分析

一、中国铜矿资源产业投资政策解读

二、中国宏观经济环境分析

第二节 2014-2019年中国铜箔市场投资机会分析

一、铜箔行业成为新的投资热点

二、铜箔细分产品投资机会分析

三、铜箔产业相关政策调整投资机会分析

第三节 2014-2019年中国铜箔市场投资风险预警

一、宏观调控政策风险

二、市场竞争风险

三、原料供给风险

四、市场运营机制风险

第四节 博思数据投资建议

图表目录：

图表：国内生产总值同比增长速度

图表：全国粮食产量及其增速

图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%）

图表：社会消费品零售总额增速（月度同比）（%）

图表：进出口总额（亿美元）

图表：广义货币（M2）增长速度（%）

图表：居民消费价格同比上涨情况

图表：工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）

图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%）

图表：农村居民人均收入实际增长速度

图表：人口及其自然增长率变化情况

图表：2013年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）

图表：2013年房地产开发投资同比增速（%）

图表：2014年中国GDP增长预测

图表：国内外知名机构对2014年中国GDP增速预测

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/jinshu1312/D571988RS2.html>